

平成 30 年 5 月 10 日

各 位

会 社 名 T O W A 株 式 会 社  
 代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 岡 田 博 和  
 (コード番号 6315 東証第一部)  
 問 合 せ 先 経 営 企 画 本 部 長 柴 原 信 隆  
 T E L (075) 692 - 0251

## 平成 30 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 値 と 実 績 値 と の 差 異 に 関 す る お 知 ら せ

当社は、平成 29 年 11 月 6 日に公表いたしました平成 30 年 3 月 期の通期連結業績予想値および通期個別業績予想値と本日公表の実績値に差異が生じたので、下記のとおりお知らせいたします。

### 記

#### 1. 平成 30 年 3 月 期 通 期 業 績 予 想 値 と 実 績 値 と の 差 異

(平成 29 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日)

##### (1) 連結業績

|                               | 売上高           | 営業利益         | 経常利益         | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------|
| 前回発表予想 (A)                    | 百万円<br>30,605 | 百万円<br>4,491 | 百万円<br>4,521 | 百万円<br>3,057    | 円 銭<br>122.23      |
| 実績値 (B)                       | 31,010        | 3,682        | 3,540        | 3,026           | 121.02             |
| 増減額 (B - A)                   | 405           | △ 808        | △ 980        | △ 30            |                    |
| 増減率 (%)                       | 1.3           | △ 18.0       | △ 21.7       | △ 1.0           |                    |
| (ご参考) 前期実績<br>(平成 29 年 3 月 期) | 27,632        | 3,831        | 4,131        | 3,867           | 154.64             |

##### (2) 個別業績

|                               | 売上高           | 経常利益         | 当期純利益        | 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 |
|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------------|
| 前回発表予想 (A)                    | 百万円<br>28,131 | 百万円<br>2,713 | 百万円<br>2,011 | 円 銭<br>80.41       |
| 実績値 (B)                       | 28,475        | 1,741        | 2,082        | 83.25              |
| 増減額 (B - A)                   | 344           | △ 971        | 71           |                    |
| 増減率 (%)                       | 1.2           | △ 35.8       | 3.5          |                    |
| (ご参考) 前期実績<br>(平成 29 年 3 月 期) | 25,591        | 2,383        | 2,862        | 114.44             |

#### 2. 差異の理由

当連結会計年度の売上高につきましては、スマートフォン 1 台あたりのメモリー搭載容量増加やデータセンターの増設などによる DRAM、NAND 型フラッシュメモリーの旺盛な需要および仮想通貨の市場拡大により膨大な計算を高速で処理する高性能な半導体の需要押し上げなどにより、前回発表予想値を上回ることができました。一方、損益におきましては、設計の自動化や海外生産子会社からの直出荷体制の構築など生産性の効率化を図ってまいりましたが、お客様による WLP (Wafer Level Package) や PLP (Panel Level Package) の試作評価が当社想定よりも時間を要していることにより、コンプレッション装置の売上比率が低下するなど製品ミックスによる要因に加え、受注・売上高の増加や短納期対応により外注協力会社への費用が増加した結果、各段階利益ともに前回発表予想を下回る結果となりました。

以 上